

证券代码：688220

证券简称：翱捷科技

翱捷科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-0402

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	海通证券、百年保险、海通国际 淡水泉、德邦证券、东吴基金 光大证券、广发基金、国联证券 国泰君安、海富通、红杉中国 湖南源乘、华润元大、华泰证券 汇丰晋信、嘉合基金、嘉实基金 民生加银、农银人寿、上海峰岚 盘京资产、于翼资产、申港证券 太平基金、泰康资产、天风资管 西部证券、西南证券、香港沪光 兴合基金、兴证全球、易方达 长盛基金、中保投、中金公司 中金基金、中信保诚、中邮人寿 大家资产、大成基金、博时基金 China Pinnacle Equity、UBS Hel Ved Capital、Point72
时间	2024年4月2日
上市公司接待人员姓名	董事长                                      戴保家 董事、董事会秘书、副总经理      韩旻 证券事务代表                            白伟扬
投资者关系活	

<p>动主要内容介绍</p>	<p><b>Q: 请问公司公告的核心技术人员变动对公司预计有何影响?</b></p> <p>A: 不会对公司经营造成影响。主要原因有:</p> <p>1) 该离职的核心技术人员邓俊雄先生离职后, 其任职期间所负责的业务将由公司内部现有成熟的团队承接, 现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发, 本次核心技术人员的调整不会对公司技术研发、核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响。</p> <p>2) 邓俊雄先生在公司工作期间未申请专利, 参与申请的布图及其他工作相关的知识产权均归属于公司所有, 不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷, 邓俊雄先生的离职不影响公司知识产权的完整性。</p> <p>3) 邓俊雄先生在任职期间主要负责公司非蜂窝物联网产品方面的研发设计工作, 非蜂窝物联网产品目前占公司收入比例较低。随着公司在各类通信技术的累积及相关产品的不断演进, 公司主营向蜂窝基带芯片的研发与销售聚焦。</p> <p><b>Q: 请问公司 5G RedCap 产品进展如何?</b></p> <p>A: 2023 年国内各大运营商都在加快对 RedCap 网络商用的部署, 公司作为产业中坚力量, 也做了很多推进工作, 包括积极参与行业标准制定, 推进 5G RedCap 技术演进, 大力投入产品研发及产业化, 截止到目前, 公司首款 5G RedCap 芯片已经问世, 客户关注度较高, 2024 年, 公司将加大对该产品的研发及市场推广力度, 实现量产出货。</p> <p><b>Q: 请问公司对 4G 物联网芯片 2024 年市场需求如何展望?</b></p> <p>A: 从近期公司与客户沟通的情况来看, 根据客户需求、项目进展结合公司产品方案匹配情况, 公司对 2024 年整体</p>
----------------	---

情况相对乐观。随着公司新产品的推出、新客户的拓展，预计在智能可穿戴、车联网、MBB 市场等细分领域将会继续扩大销售规模。

**Q: 请问公司芯片产品的制程水平如何？产能是否供应充足？**

A: 公司当前 4G 芯片产品的制程主要以 22nm 为主，截至目前各合作厂商对公司提供产能供应充足，尚没有看到因产能不足而导致缺货的风险。

**Q: 请问公司 4G 智能手机芯片下一代产品进展如何？**

A: 公司 4G 智能手机芯片下一代产品已经在研发中，目前项目进度保持正常推进。2024 年下半年公司会根据终端应用反馈以及市场发展情况，适时推进下一代产品的商业化进程。

**Q: 请问公司 2023 年第四季度毛利率环比有所下降的原因？对 2024 年毛利率如何展望？**

A: 2023 年第四季度综合毛利率环比第三季度降大概 1 个百分点，主要是由于收入构成结构变化导致的。公司的综合毛利率水平还是主要由市场竞争程度而定，目前评估 2024 年毛利率暂仍有压力，不排除继续下探的可能。

**Q: 请问公司如何展望 2024 年研发费用情况？**

A: 作为芯片设计企业，公司始终注重研发创新，持续保持研发投入，但随着公司研发体系建设趋于完善、人才队伍培养逐渐完备，基于公司目前的市场及产品规划，未来几年人员大规模扩张的可能性较低，公司研发费用增速可控。

**Q: 请问公司在海外市场的布局规划如何?**

A: 公司从 2022 年开始加大海外市场推广力度, 目前已经取得较为不错的进展, 2023 年 ASR1606 芯片已经获得北美主流运营商认证, 可助力客户项目顺利进入北美市场; 在印度市场, 产品成功进入印度最大的运营商 Reliance Jio、最大的支付牌照品牌商 PayTM 以及最大的运营商支付品牌商 JioPay 的供应链。除此之外, 在南美、非洲等也都作了部署与规划, 整体海外市场的发展取得了一定的成绩。

**Q: 请问公司今年端侧和定制化的 AI 芯片的进展如何? 是否有低轨卫星的基带芯片产品?**

A: 在端侧方面, 去年公司已发布公告, 尽管仍长期看好智能 IPC 的应用前景, 但基于谨慎原则和合理利用募集资金原则, 为降低项目收益的不确定风险, 公司经审慎评估决定对“智能 IPC 芯片设计项目”予以终止, 变更该项目全部剩余募集资金到“新一代智能可穿戴设备软硬件平台开发项目”。

在芯片定制业务方面, 目前跟既有客户的合作关系保持正常。

在卫星通信相关芯片方面, 公司持续关注卫星通信市场发展动态及需求情况, 国电高科已经选定了公司一款产品 ASR6601 进行合作, 并计划在 ASR6601 的基础上, 联合开发一款针对其天启星座的 CHIRP 扩频射频通信 SoC 芯片, 可用于特殊行业的应急设备等领域。公司判断, 市场容量扩展尚需较长时间, 短期对公司营收贡献极小。关于专门支持手机卫星通信芯片, 在技术方面目前已经有充分的积累, 但由于资源有限, 尚无形成具体产品, 后续持续关注该市场发展, 择机将相关产品落地。

---

附件清单（如有）	无
----------	---